

EDAX / TSL 材料分析セミナー

「材料を解く…様々な顔を見せる材料の特性を元素と組織から解く」

このテーマのもと、アメテック株式会社エダックス事業部と株式会社 TSL ソリューションズでは、材料分析セミナーを企画しました。EDS 関係を中心に X 線分析装置を取扱う EDAX 製品と、EBSD 関係を中心に組織解析装置を取扱う TSL 製品について、それらの分析手法、アプリケーションあるいは装置の動向等に関し、両者が持つ技術を総動員してご紹介いたします。分析手法や装置の最新情報を把握し、分析手法の幅を広げたいとお考えの皆様の参加をお待ち申し上げております。

記

【開催日および会場】

東京会場 平成 30 年 5 月 25 日(金) 化学会館 (御茶ノ水駅から徒歩 10 分)
大阪会場 平成 30 年 6 月 20 日(水) 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)
(地下鉄中之島駅前)

【セミナー内容】

9:30 – 10:00 : 受付
10:00 – 10:10 : 開始のご挨拶
10:10 – 10:40 : シリコンナイトライド EDS 検出器の特長とその応用
10:40 – 11:20 : 最新 EBSD 事情と Analysis8 解析能力のご紹介
11:20 – 11:50 : EDS・EBSD 同時検出のメリットとその応用
昼 食
13:00 – 13:40 : TEM を用いた結晶方位マッピング… NanoMEGAS 社
ASTAR/TOPSPIN のご紹介
13:40 – 14:20 : ミクロからマクロまで SEM+EDS/WDS と μ EDXRF 分析の
ご紹介
14:20 – 15:00 : [東京会場] 半導体パッケージの不良解析と EBSD 測定
(中谷 瑞葉 様/ 東芝ナノアナリシス株式会社)

[大阪会場] EBSD-EDS 同時分析による相解析および透過 EBSD 法に
よる空間分解能の向上への取組み
(安田 光伸 様/ 株式会社東レリサーチセンター)

休 憩

15:20 – 15:50 : OIM と In-Situ 実験装置の融合

15:50 – 16:10 : CrossCourt を用いた弾性歪測定のご紹介

16:10 – 16:30 : TSL ソリューションズ が取組む EBSD 派生技術

16:30 – 16:35 : 閉会のご挨拶

【定 員】

東京会場 80 名

大阪会場 60 名

- 先着順で、定員になり次第締め切りとさせていただきます。
- お申し込みは 1 部署(1 研究室) 2 名様まででお願いいたします。

【参加費】

無 料

【お申込み】

4 月 1 日より受付を開始いたします。下記 TSL ソリューションズ ホームページのお知らせ「EDAX/TSL 材料分析セミナー開催のご案内」からご希望の会場を選択し、お申込みください。

www.tsljapan.com

折り返し、お申込み受付の返信メールをお送りいたします。1 日待っても受付メールが届かない場合は、下記あてお問い合わせください。

なお、募集人員を超えた場合は、キャンセル待ちとして改めてご連絡させていただきます。

本イベントに関するお問い合わせは、下記までお寄せください。

TEL 042-774-8841

✉ tsl-event@tsljapan.com

担当 鈴木 智子

